

产品工艺确认书

文件编号:		HS9069-SOP8					
客户		080106		封装形式		SOP8	
一、芯片资料				二、粘片及打线图		三、传送方向	
产品型号		HS9069					
芯片数		芯片a 芯片b					
芯片型号		HS5156					
芯片尺寸(um ²)		429.4*353.4					
铝垫尺寸		48.45*48.45					
划片道宽度(um)		60					
芯片背面材质							
铝垫厚度(um)		0.8					
是否为MOS或BJT		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否					
铝垫成份		<input type="checkbox"/> 纯铝					
		<input type="checkbox"/> 铝铜					
		<input type="checkbox"/> 铝硅					
		<input type="checkbox"/> 铝硅铜					
铝层数		<input type="checkbox"/> 单层布线					
		<input type="checkbox"/> 双层布线					
		<input checked="" type="checkbox"/> 三层布线					
四、封装资料				五、打印要求			
芯片数		芯片a		芯片b		<p>背印:</p> <p>969-A59Y</p>	
是否要减薄		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
减薄厚度要求		300um±10um					
焊垫是否为CUP		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
六、封装其它要求						八、备注 标签 规格: 80*50mm	
包装规范		OS+管装100PCS/管 100K/箱					
装片方式		点胶					
上芯方式		MAP芯片					
工作电压							
工作电流(A)							
工作结温Tj							
可靠性要求							
七、物料清单BOM							
材料		型号					
框架		SOP8铜框架 (60*60mil)					
焊线		合金线0.7mil (18um) (9wire)					
粘片胶	芯片a	<input checked="" type="checkbox"/> 导电胶 <input type="checkbox"/> 绝缘胶		首选:	S210	备选:	
	芯片b	<input type="checkbox"/> 导电胶 <input type="checkbox"/> 绝缘胶		首选:		备选:	
塑封料		<input type="checkbox"/> 无铅 <input checked="" type="checkbox"/> 无卤		首选:	DY600	备选:	
电镀类型		雾锡					
拟制		姜敏		审核		胡伟	
日期		2024年11月7日		日期		2024年11月7日	
九、备注说明							
<p>1、客户在回签此确认书时,要求填写芯片资料、封装资料及封装其他要求中的有关内容,以便于设置封装工艺。若未填写,我司就以我司工程验证的信息内容为主进行生产;</p> <p>2、根据贵司要求,参照贵司提供订单、芯片打线图及印章要求制定本工艺确认书。客户确认打线、印章图是否符合客户要求,请确认;</p> <p>3、客户在确认此文件时,对产品使用要求,如散热、工作电压、工作电流、工作结温及可靠性要求进行填写,以便于我司根据贵司使用要求进行物料选取。若未进行填写,我们就以本确认书推荐物料进行生产。</p> <p>4、对双方质量协议、终端使用环境要求了解的情况下,客户确认回签此文件。若终端使用环境要求有改变,须提前告知我司;</p> <p>5、产品完成工程试封后,客户端务必进行终端使用环境及电性能测试(如带电老化),考核通过后才能进行量产。</p>							
十、客户回签及特殊要求							
客户要求及回签							